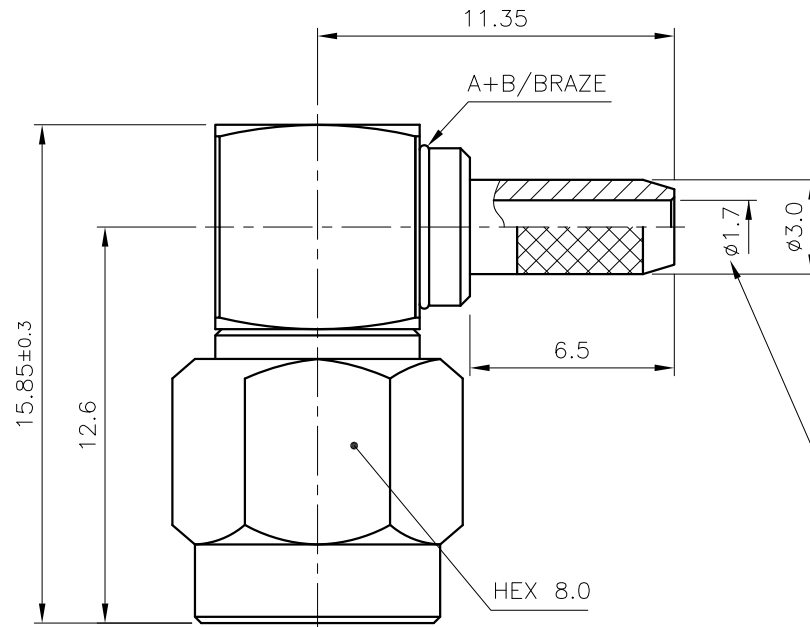


A

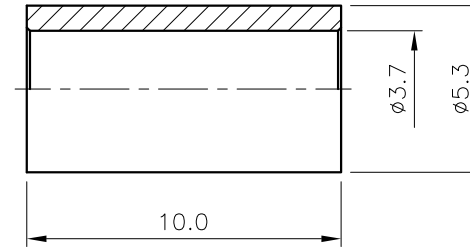
B

C

D



하이스핀 Ø1.7 삽입하여 전수 검사 할 것
(BODY 간 내부 은땜 흐름 및 용침 여부 확인)

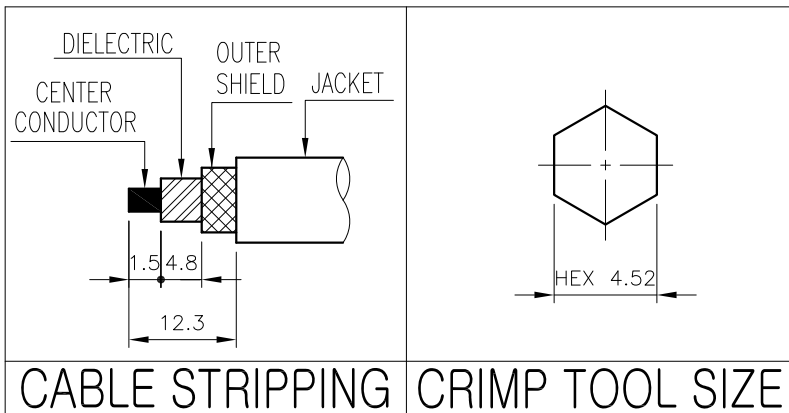


REVISION

REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	I.C.KIM	Y.H.CHO	2011.06.20.
1	[설번처리No.201204-0005] body 면취 추가	I.C.KIM	J.H.YOUN	2012.04.10.
2	BODY 일체형 변경으로 인한 완제품 CODE 폐기 및 BODY 모따기 수정	C.K.KIM	I.C.KIM	2016.01.28.
3	[설번처리No.201606-0001]Cover 들뜸 및 비정상적으로 안착되는 현상으로 인한 Cover CODE 변경	C.K.KIM	I.C.KIM	2016.06.09.
4	DCO00026-5/2 불량으로 인한 변경	G.Y.KIM	I.C.KIM	2017.02.06.
5	바디 A+B 억지끼움 후 용접으로 치수 공차 변경	S.H.KIM		2023.06.21.

주 기

1. 체결 부적합 발생(원형 BODY 부적합) 검사
2. 부품 누락 검사
3. 완제품 조립후 상대물과 전수 체결 검사 실시 -> CAP 나사 체결 부적합
4. COVER 형상 동일한지 확인하고 포장 할 것 (이종품 혼입 주의)
5. Connector 이종품 혼입 주의
6. 이물질 및 Burr 확인
7. 포장시 수량 확인 ※ 수입 검사 및 완제품 조립시 검사 확인 할 것 ※



4 3

5 1

5 2

8	SPRING RING	1	SUS304	Passivated	DSR00002-5/1
7	COVER	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCO00031-5/1 DCO00026-5/2
6	CAP	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCU00005-5/1
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00090-N/1
4	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00004-N/1
3	FERRULE	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DFE00158-5/1
2	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCT00300-5/1
1-2	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DBD01657-1/4 DBD01657-3/1
1-1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DBD00027-5/3 DBD00027-5/1 DBD00216-1/3 DBD00216-3/2
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal ±0.2	DATE	2023. 06. 21.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle ±1°	APPROVED BY			
MATERIAL		CHECKED BY			TITLE
FINISH		DRAWN BY	S.H.KIM		SMA50 CABLE PL 1.5DS-QEHV[TA]
	SCALE 4/1	UNIT mm			A4 DWG NO. CN01092-7/2 REVISION 5 SHEET 1 of 1

A

B

C

D